

## 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、基本情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书一份。具体情况如下：

实用新型名称：一种集成电路基板

证书号：第 6258586 号

专利号：ZL 2016 2 1401379.8

专利类型：实用新型

专利申请日：2016 年 12 月 20 日

专利权人：圣邦微电子（北京）股份有限公司

授权公告日：2017 年 6 月 27 日

专利权期限：本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。

本实用新型专利涉及集成电路封装技术，特别是一种集成电路基板，所述基板包括覆铜芯板，通过在覆铜芯板中设置容纳磁环的环形槽，有利于提高或扩展集成电路封装基板的电路功能，例如能够通过对沿磁环内外分布的过孔进行绕制连接以将微变压器集成在集成电路基板内。

上述实用新型专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，对公司开拓市场及推广产品产生积极的影响，形成创新机制，保持公司技术的领先性，提升公司的核心竞

争能力。

## 二、 备查文件

中华人民共和国国家知识产权局颁发的第 6258586 号专利证书。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

二〇一七年七月十八日